

環境対応 × 高性能
LBM でつくる次世代実装

FLF01-LBM

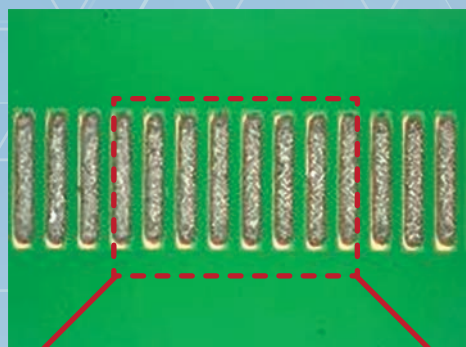
ハロゲンフリーの安心を、確かな接合品質で

■優れた印刷性

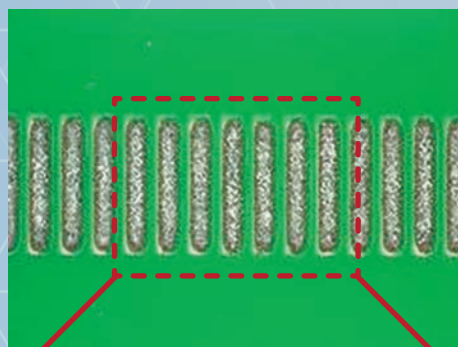
条件：メタルマスク厚：150 μm / 粉末サイズ 20 ~ 38 μm
連続印刷性 (0.4mm ピッチ QFP)

試験条件：50 枚の連続印刷を実施後に状態を観察

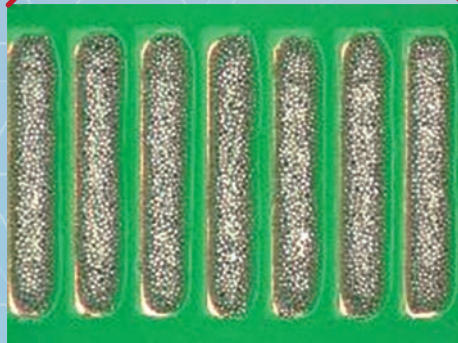
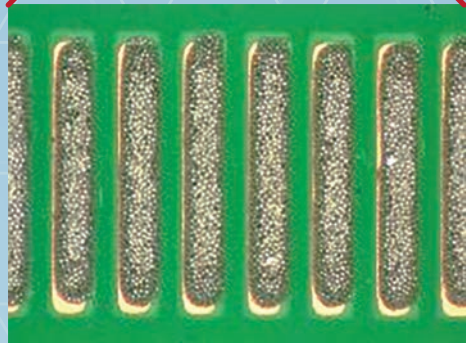
初期



50 枚目



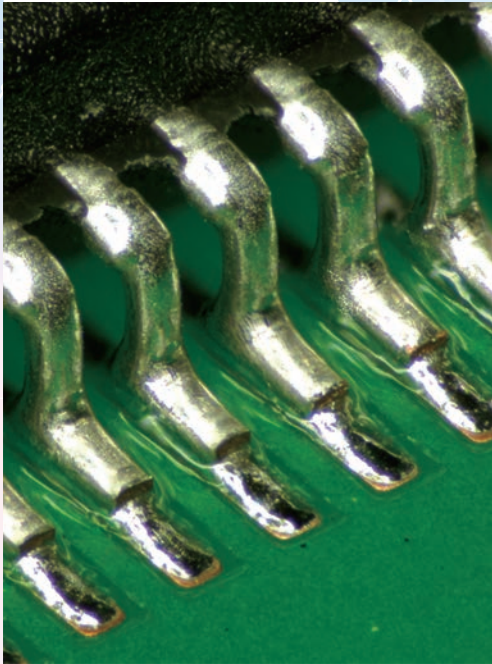
拡大



50 枚の連続印刷においてもブリッジがなく、**抜け性の良好な印刷**が可能

■優れた濡れ性

D2PAK 部品



0.5mmピッチ QFP



■特性一覧表

項 目	FLF01-LBM	試験規格 (SPEC)
合金組成 (%)	Sn-3.0Ag-0.5Cu	—
融点 (固相線温度/液相線温度)	217℃ / 219℃	DSC
はんだ粉末サイズ	Type 4: 20~38μm Type 5: 15~25μm	IPC.J-STD-005A (Type4 / Type5)
フラックス含有量 (%)	11.0 ± 1.0	JIS Z 3197
ハライド含有量 (%)	0.04	JIS Z 3197
フラックス活性分類	ROL 0	IPC.J-STD-004C
粘度 (Pa・s)	190 ± 20	Malcom PCU-258 10rpm, at 25℃
ソルダーボール試験	初期 Class 2 ➡ 24h後 Class 2	JIS Z 3284-4
粘着性	初期: 100gf 以上 24h後: 90gf 以上	JIS Z 3284-3
濡れ効力試験	Cu 86% Ni 83% 区分 2	JIS Z 3284-4 Cu 80%Over/Ni 70%Over
銅板腐食試験	腐食なし	JIS Z 3197
銅鏡腐食試験	抜けなし	JIS Z 3197
表面絶縁抵抗試験 (Ω)	1.0 × 10 ⁸ 以上	JIS Z 3197 85℃/85%RH/168hrs